

# 綠色文件簡介

---

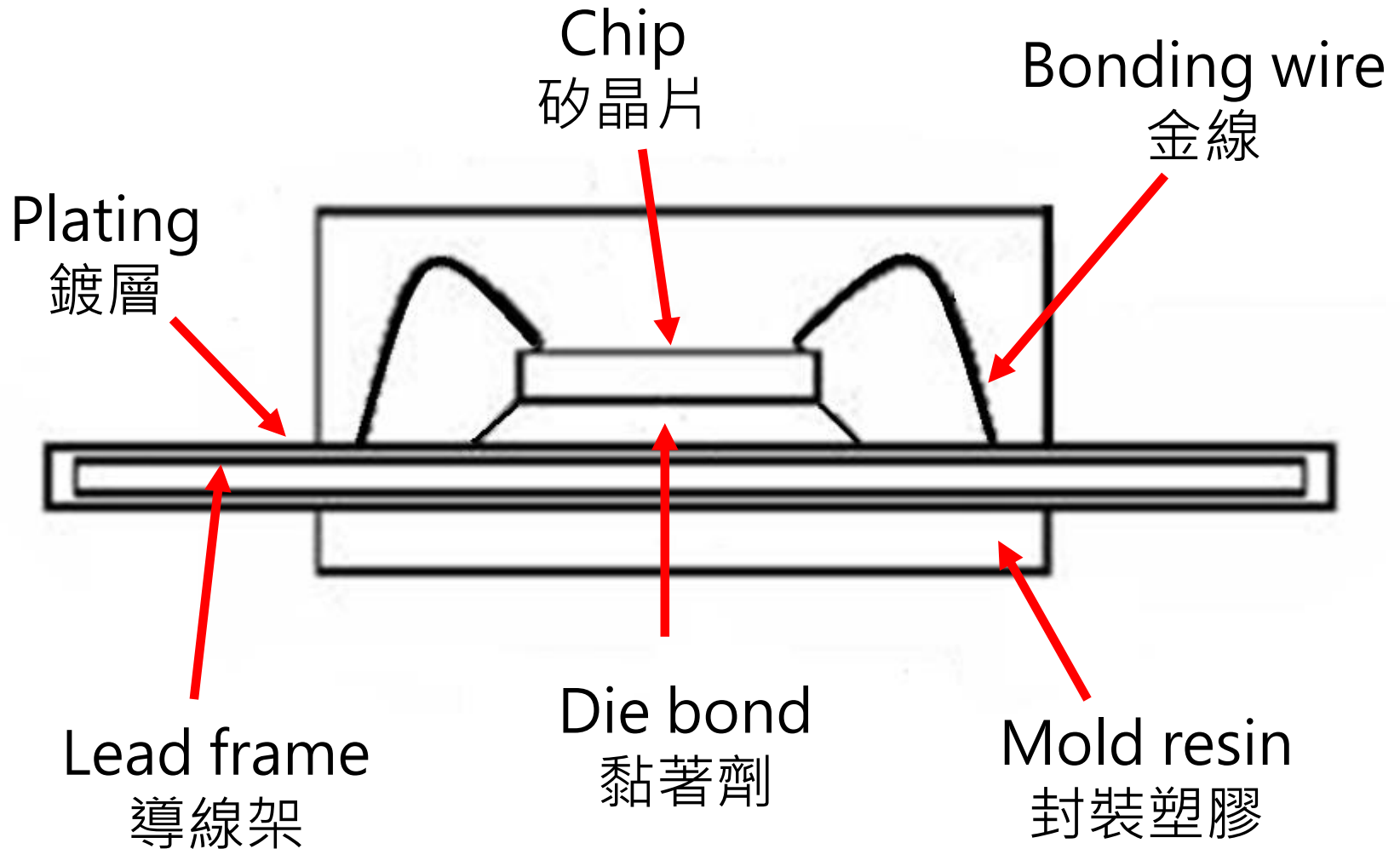
Reported : 台北工程部 Olive

Date: Oct 10<sup>th</sup> 2015

Update : Jan 15<sup>th</sup> 2016

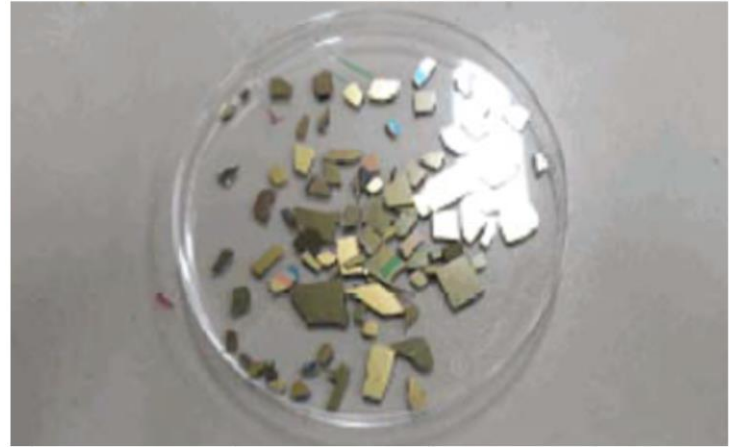


- IC組成介紹
- 國際環保法令發展趨勢  
(WEEE、RoHS、RoHS2.0、REACH、HF)
- 衝突礦產介紹
- 分測報告、混測報告介紹
- 材質成份表介紹
- 常見問題



Chip:矽晶片

---



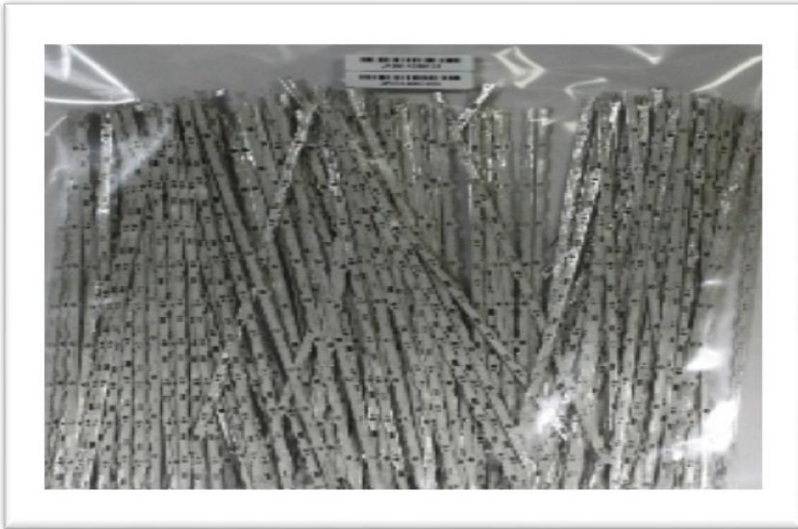
Die bond:黏著劑

---



Lead frame:導線架

---

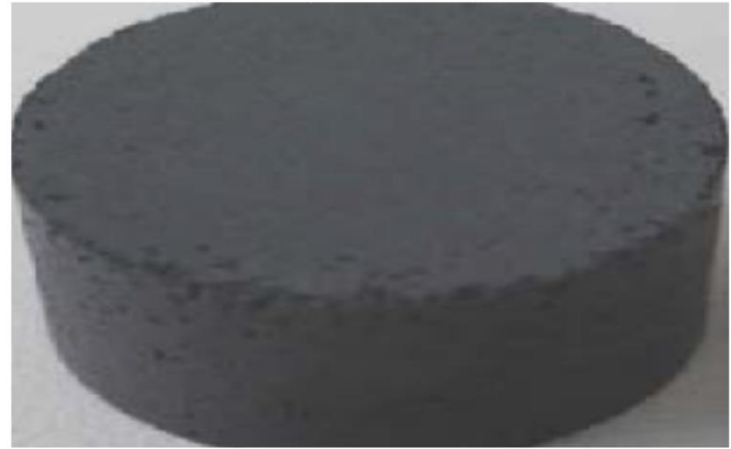


Plating:鍍層

---

Mold resin:封裝塑膠

---



Bonding wire:金線

---



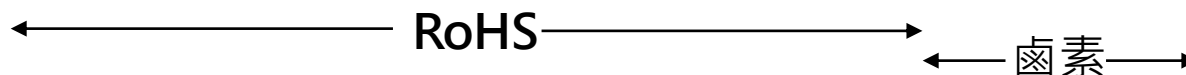
## 金屬材質

- Chip-矽晶片
- Lead frame-導線架
- Plating-鍍層
- Bonding wire-金線

## 非金屬材質

- Die bond-黏著劑、膠
- Mold resin-封裝塑膠

報告測試項目要求	Pb	Cd	Hg	Cr6+	PBBS	PBDS	Br	Cl
金屬	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
非金屬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



◎為必檢測項目



2005/08/13 新增 WEEE

2006/07/01 新增 RoHS

2006/12/27 新增 PFOS

2007/6/1 新增 REACH

2007/8/11 新增 EuP

2008/1 新增 HF

2010/11/20 新增 ErP

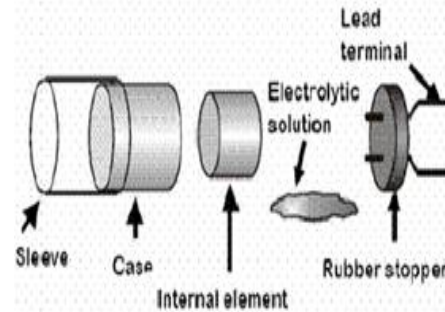
2013/1/2 新增 RoHS 2.0



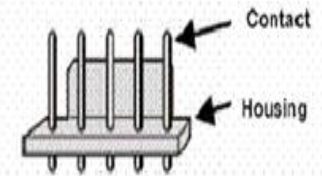


類型	說明
分測報告	拆解零件各個部位，對拆解後部位進行分析的測試報告。
混測報告	零件無經過拆解的測試報告。 (Ex: IC、電阻、電感)

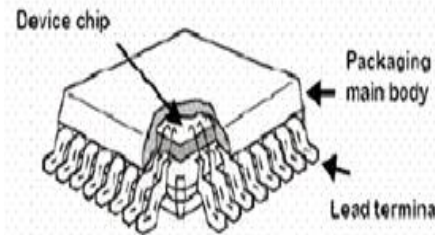
## • Resistor、Capacitors



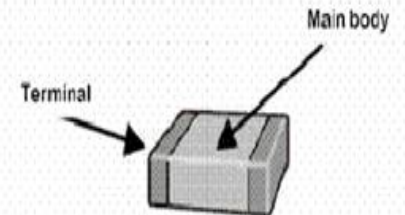
## • Connector



## • Semiconductor device(i.e IC)



## • Surface-mounted chip parts (SMD)





欲知詳情請洽...

**AENEAS**

---

## FAE team

王立文(Leo) [leo@aeneas.com.tw](mailto:leo@aeneas.com.tw) (02)87974259#720

廖文綺(Olive) [olive@aeneas.com.tw](mailto:olive@aeneas.com.tw) (02)87974259#626

## Ricoh 官網資訊:

[http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product\\_power/](http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/)



**Thank You**

